

旭鼎產品

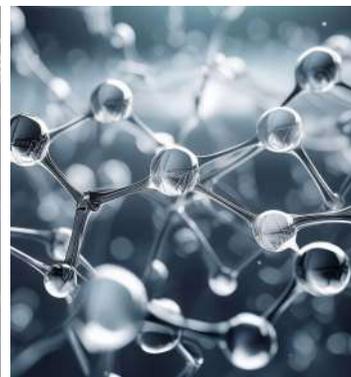
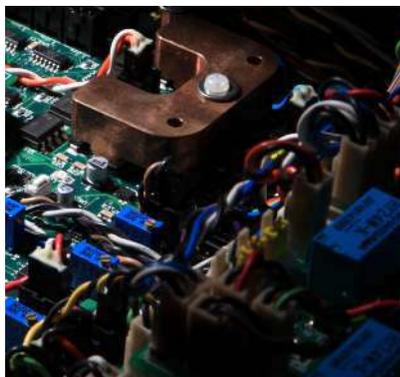
- 點狀式常壓電漿設備
- 寬幅式常壓電漿設備
- 連續式 (in-line) 電漿清潔設備
- 抗汙膜 / 抗指紋膜 常壓蒸鍍機
- 電漿清洗機
- 電漿去膠渣機
- 電漿去光阻機
- 電漿蝕刻機
- 接觸角量測儀
- 微氧分析儀
- 流量控制器
- 電漿電源供應器
- 類鑽碳鍍膜系統
- 電漿系統 ODM
- 各式鍍膜代工
- 刀具

旭鼎實績

友達光電、群創光電、奇菱科技、帝寶車燈、大億工業、福懋科技...等

應用產業

- LCM 貼合製程清潔 (COG、COF)
- Touch Panel 製程
 1. Cover lens coating製程前清潔
 2. Touch sensor Pr製程前清潔
 3. 貼合製程前清潔
 4. 連接FPC端子製程前清潔
- LED、IC 封裝製程
 1. die attach前清潔
 2. molding前清潔
 3. wire bond前清潔
- 汽車產業
 1. 車燈黏接前清潔
 2. 汽車鈹金防水條/塑膠條黏接前清潔
- 鞋業 / 各式塑料
貼合前清潔
- 各式軟 / 硬板製程
 1. 軟硬複合板壓合前清潔
 2. 水平/垂直電鍍前清潔
 3. 綠漆前清潔
 4. 雷射鑽孔後之殘餘膠渣去除
- 晶圓製造
 1. 殘餘光阻去除
 2. 藍膜殘膠清潔
 3. PSS製程來料清潔
- 各式光學塑膠基材塗佈、鍍膜、印刷前清潔
- 各式基材表面清潔、活化、改質
- 太陽能電池(片)蝕刻 (Edge isolation)



一、常壓電漿設備 / 常壓塗佈設備



SAP003
點狀式常壓電漿模組



SAP006
寬幅式常壓電漿模組



SAP009T、SAP009SA
常壓電漿清潔模組



抗汗膜 / 抗指紋膜
常壓蒸鍍機



指紋辨識晶片
有色精密塗佈機

二、低壓電漿設備



RPA12
RIE電漿蝕刻機



PC03 / PC04
低壓電漿清潔設備



PA03B
電漿去光阻機



PD06
電漿去膠渣機



IPC04
In-line 電漿清潔設備

三、各式鍍膜代工



Diamond
鑽石鍍膜



DLC
類鑽碳鍍膜



TiN



刀具

四、測量 / 控制儀器



CAM120
接觸角量測儀



CAM210
接觸角量測儀



COA011
微氧分析儀



MFC001
流量控制器



電漿電源供應器



特點

- 世界最小型的抗指紋連續塗佈設備、佔地小、產能高
- 適用各大廠藥水，水滴接觸角達110-120°，耐磨達3000次
- 與連續生產線結合，可連續操作
- 輸送帶設計，適合不同試片尺寸及方便規格切換
- 專利設計、單面塗佈、操作簡單、塗佈品質佳

全方位
抗指紋技術



應用

觸控面板保護玻璃、電視保護片、透明基板抗汙、
電子紙螢幕、PDA、衛星導航螢幕、眼鏡抗汙處理、
滑鼠、抗汙USB鍍膜、PCB防鏽、減少摩擦損耗

Model number		AS 750 Specification	
No	Item	Specification	
1	Dimensions (mm)	4500(W) × 1350(D) × 2203(H)	
2	weight	~2000kg	
3	Effective width	750mm	
4	Producing Speed	0.5m ~ 1M/min	
5	Pass line	980mm ± 20mm	
6	Feed methods	I From right to left I Series connect to up and down equipment, support by tray or directly transfer on roller	
7	Number of spray nozzle	3 pcs	
8	Chemical consumption	8~12g/min (per spray nozzle)	
9	Tank	2*Volume 5L	
10	Liquid dosage control	Automatic liquid dosage control deviation ± 0.5g	
11	Plasma	Specification CNT-SAP006 R80Q	
	Output Power	1000~1500W	
	Clean Height	1-3mm	
	N2 (For plasma)	Purity:99.99% Pressure:7kg/cm ² Diameter :ø16mm PU tube Flow Rate : 400~540L/min Air with oil content :<0.003ppm Air with water content :Dew point <-23 °C	

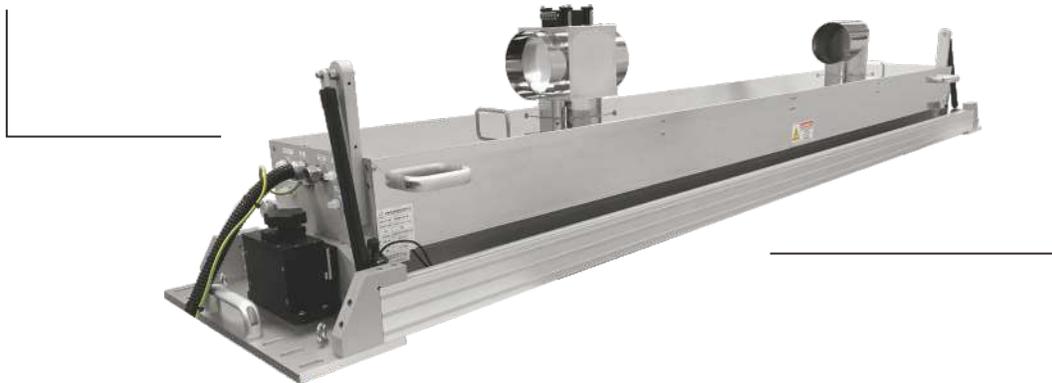


SAP006 系列

可以在大氣的環境下，快速的清除有機汙染物，達到元件表面清潔及改善的功能，有效提升元件封裝、黏著、印刷之可靠度

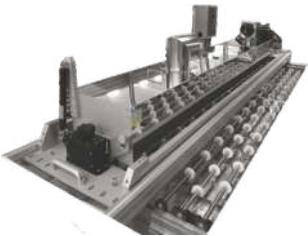
特點

- 無電弧擊傷、無 ESD 問題
- 低溫電漿、可對應各式基板
- 最小化的電極設計，可雙面處理
- 高效的清潔能力、高速的處理、大面積的清潔
- 客製化設計、可廣泛的應用於 In line 產線
- 不需特殊氣體、氣體成本低廉、可取代 UV/EUV



應用

- AG、AR、AF 鍍膜前處理
- 油墨印刷、鍍膜、噴塗前處理
- PET、PE、PI 等塑膠素材表面改質
- 半導體成型、封裝、印刷、打線前處理
- 手機、觸控面板的玻璃清潔、貼合前清潔
- PCB/FPC 電路基板清洗 / 鍍銅化銅前 / 鍍金前製程
- LCD/OLED 玻璃基板清洗 / ITO / 蝕刻 / PVD、CVD前等製程
- 去除有機物、表面活化、提高潤濕性、增加附著力等應用

電漿系列	SAP006-R(N ₂ Plasma)	SAP006-RF(Ar Plasma)
設備樣式		
放電方式	DBD type	DBD type
製程氣體	N ₂ 、CDA	Ar、O ₂
有效寬度	Max.3370mm(G10.5)	Max.1850mm
清潔高度	1~5mm	<4mm(需要導體面)
噴口型式	Slit type、Hole type	Slit type
電源規格	MF Power 3Ø220V±10%·50/60Hz	RF Power Ø220V±10%·50/60Hz
額定功率	2、4、6、8、12、16kW	0.6、1、2kW
對應速度	<10M/min	<10M/min



SAP013 系列

由旭鼎公司自主研發製造，榮獲多項專利認證，在大氣環境下，可快速清除有機汙染物，達到元件表面清潔及改善的功能，有效提升元件封裝、黏著及印刷之可靠度

特點

- ⊕ 與連續生產線結合，可以連續操作
- ⊕ 使用價格低廉的 CDA 或 N2
- ⊕ 乾式製程，無廢水排放問題
- ⊕ 適用於多種材料清潔活化：
金屬、玻璃、塑料

應用

- ⊕ LCD 面板電極
- ⊕ 軟性電路板電極、BGA 電路板電極
- ⊕ LED 電極
- ⊕ PCB
- ⊕ 各式上色或上膠前處理
- ⊕ LCD or OLED glass cleaning process
- ⊕ 醫療材料
- ⊕ 電池封裝
- ⊕ 印刷塗料前處理
- ⊕ 覆膜紙盒上膠黏合前處理
- ⊕ Touch Panel

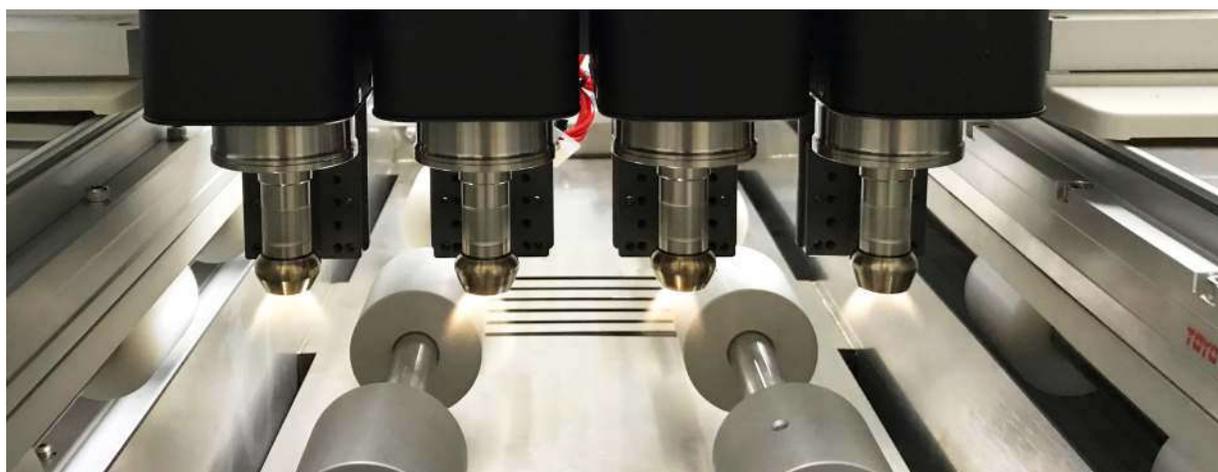


項 目	SAP013RZ	SAP013RT	SAP013XR
功 率	350~600W	600~800W	900~1100W
工 作 氣 體	CDA / N2	CDA / N2	CDA / N2
輸 入 電 源	AC220V(單相) 50~60Hz		
氣 體 壓 力	4.6±0.8kg/cm ²		
控制部尺寸 (W×D×H) 重 量	484×704×134mm 25kg		
照 射 部 尺 寸 (Φ×H) 重 量	74×110×243mm <3kg	74×110×243mm <3kg	80×124×284mm <3kg



SAP013 系列 常壓式電漿清潔設備

項目	SAP013XR (一對二)	SAP013XR (一對四)	SAP013XR (一對六)
功率	1800~2200W	3600~4400W	5400~6600W
工作氣體	CDA / N2	CDA / N2	CDA / N2
輸入電源	AC220V(單相) 50~60Hz		
氣體壓力	7±0.5kg/cm ²	7±0.5kg/cm ² (2條管路)	7±0.5kg/cm ² (3條管路)
控制部尺寸 (W×D×H) 重量	530×850×1063mm 150kg	790×740×1317mm 230kg	980×980×1800mm 350kg
照射部尺寸 (Ø×H) 重量	80×124×284mm <3kg	80×124×284mm <3kg	80×124×284mm <3kg
可選購不同噴嘴符合不同清潔範圍需求			
清潔範圍	A10	A15	A30
	10~13mm	15~20mm	25~30mm
操作高度	20mm	20mm	10mm
清潔範圍	A45	A50	A70
	40~45mm	50~53mm	65~70mm
操作高度	8mm	15mm	5mm



SAP013 系列

由旭鼎公司自主研發製造，榮獲多項專利認證，在大氣環境下，可快速清除有機汙染物，達到元件表面清潔及改善的功能，有效提升元件封裝、黏著及印刷之可靠度

特點

- 與連續生產線結合，可以連續操作
- 使用價格低廉的 CDA 或 N2
- 乾式製程，無廢水排放問題
- 適用於多種材料清潔活化：
金屬、玻璃、塑料

應用

- LCD 面板電極
- 軟性電路板電極、BGA 電路板電極
- LED 電極
- PCB
- 各式上色或上膠前處理
- LCD or OLED glass cleaning process
- 醫療材料
- 電池封裝
- 印刷塗料前處理
- 覆膜紙盒上膠黏合前處理
- Touch Panel



項 目	SAP013		SAP-013T	SAP-013X
功 率	220~250W	200~290W	600~800W	1000~1200W
工 作 氣 體	CDA	N2	CDA / N2	CDA / N2
輸 入 電 源	AC220V(單相) 50~60Hz		AC220V(單相) 50~60Hz	
氣 體 壓 力	4.6±0.8kg/cm ²		4.6±0.8kg/cm ²	
控制部尺寸 (W×D×H) 重 量	484×704×134mm 25kg		484×704×134mm 25kg	
照 射 部 尺 寸 (Φ×H) 重 量	40×265mm <2kg		38×207mm <2kg	54×300mm <2kg
清 潔 範 圍	3~10mm	5~10mm	5~10mm	5~15mm
操 作 高 度	5mm	5mm	10mm	20mm



PC03 / PC04 / PA03B

各式基材在印刷或黏著前之表面活化、改質、接枝、粗糙化或清潔等

特點

- 處理均勻性佳
- 離子能量低、不損傷基板
- 沒有電極及基板的汙染
- 專利設計之特殊電漿電極
- 高密度電漿源
 - 電漿效率高、清潔效率高
 - 可控制低的離子能量
 - 結合化學反應性及物理撞擊性
- 處理速度快、清潔效率高、可靠度高
- 操作範圍廣
- 可使用多種製程氣體
- 全自動且容易操作
- 設備穩定高，容易維護
- 可依客戶需求作更改



項目	PC03 / PC04	PA03B
Applications	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCM、IC封裝(Flip Chip、CSP、BGA、Lead Frame、etc.)、LED封裝、SMT、PCB、FPC、光電元件、封裝貼合前清潔 ■ 印刷或黏著前之表面粗化或清潔 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 殘餘光阻去除 ■ 藍膜殘膠去除 ■ PSS來料清潔製程
Footprint	1270(W)×1100(D)×2216(H)mm	
Chamber Size	500(W)×500(D)×500(H)mm	
Weight	880kg	
Facilities	3Ø220V×60Hz×4w，30A Compressed air：~6 kg/cm ² Reaction gas：~3 kg/cm ²	3Ø220V×60Hz×4w，50A Compressed air：~6 kg/cm ² Reaction gas：~3 kg/cm ²
System Control Software	PC or PLC	
Gas Flow System	2 mass flow controllers	1 mass flow controllers
Vacuum Pump	Rotary (80m ³ /hr) + Roots(250m ³ /hr)	Rotary pump
Reactants	O ₂ , Ar, H ₂ , N ₂ & mixing gases	O ₂ , N ₂ , H ₂ , CF ₄ , & mixing gases



各式基材在印刷或黏著前之表面活化、改質、接枝、粗糙化或清潔等

特點

- 處理均勻性佳
 - 離子能量低、不損傷基板
 - 專利設計之特殊電漿電極
 - 高密度電漿源
- 電漿效率高、清潔效率高
可控制低的離子能量
結合化學反應性及物理撞擊性
- 處理速度快、清潔效率高、可靠度高
 - 操作範圍廣
 - 可使用多種製程氣體
 - 全自動且容易操作
 - 設備穩定高，容易維護
 - 可依客戶需求作更改
 - 軌道調整容易



應用

- LCM、IC封裝 (Flip Chip、CSP、BGA、Lead Frame、etc.)、LED封裝、SMT、PCB、FPC、光電元件、電子元件、封裝貼合前清潔
- 印刷或黏著前之表面粗化或清潔

項目	IPC04	IPC02C
Footprint	2210(W)×1274(D)×2050(H)mm	2210(W)×985(D)×2050(H)mm
Chamber Size	324(W)×522(D)	324(W)×272(D)
Weight	1500kg	1300kg
Facilities	3Ø220V×60Hz×4w，30A Compressed air : about 6 kg/cm ² Reaction gas : about 2 kg/ cm ²	
System Control Software	PLC	
Gas Flow System	2 mass flow controllers	
Vacuum Pump	Rotary pump	
Reactants	O ₂ , Ar, H ₂ , N ₂ & mixing gases	
Track	4	2
Substrate Dimensions	W:50~80mm D:150~250mm	



可進行去膠渣、表面清潔、活化、改善、接枝或粗糙化等

特點

- 高密度電漿源，電漿效率高，減少製程時間
- 專利設計之特殊電漿電極
- 特殊之氣體進氣、擴散及抽氣系統設計
- 處理之均勻性佳
- 電漿均勻性佳
- 可使用多種製程氣體
- 全自動且容易操作
- 設備穩定高，容易維護
- 可根據客戶需求設計專用特殊規格之機台

應用

- PCB、FPC
- 印刷或黏著前之表面粗化或清潔



項目	PD06
設備尺寸	1100(W)×1480(D)×1220(H)mm
腔體尺寸	2000(W)×2100(D)×2626(H)mm
重量	4000kg
腔體材質	不鏽鋼製真空腔體 + 鋁製腔體門
電極數目	15組水冷電極
需求電源	3相220V，60Hz，4wires，135A
處理能力	21"x26"板材可生產28片，可調整式夾具
電源供應器	10~20 KW MF power supply
流量計	標配四顆流量計 (CF ₄ , O ₂ , N ₂ , Ar)，可另選配一顆
壓力計	Capacitance manometer
真空幫浦	Dry Pump + Roots Pump
臺車	4組臺車與置具
冷卻系統	熱交換式冰水機
溫度監測系統	設備配備溫度監測系統



PSC 630 精密噴塗設備可應用於各式塗層塗佈，模組化設計可便於串接上下游產線

特點

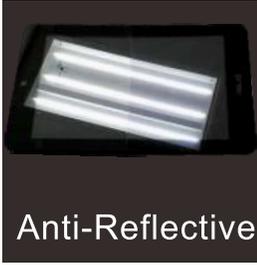
高精度流量控制/高膜層均一性，可應用於各種塗層塗佈，
 模組化設計，可依功能需求搭配上下游產線、噴室設計
 精簡，易維護保養



Anti-Smudge



Anti-Glare



Anti-Reflective

應用

- 抗指紋膜塗佈
- 抗眩光膜塗佈
- 抗反射膜塗佈
- 指紋(生物)辨識晶片
- 抗靜電膜塗佈
- 光阻塗佈
- 其他光學膜層(例如：Hard coating)



PSC630 PLUS



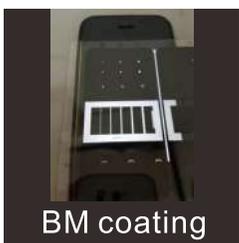
PSC630

PSC630 SPECIFICATIONS

Dimensions (L×W×H)	1700×1700×2200mm
Weight	1500Kg
Power required	3ΦAC220V, 60Hz, 30A, grounding<10Ω
Environment	Class 1000
Max. scan speed	X~800mm/s, Y~800mm/s, Z~300mm/s
Pass Line	950±20 mm
Effect area	500mm*500mm
Tray size	550mm*500mm
Transfer type	Roller
Tank	3L *1
Liquid control	Syringe pump
Option	Circulation System, Plasma unit, Loading unit, unloading unit. Easy test feed system



Thermal Insulation



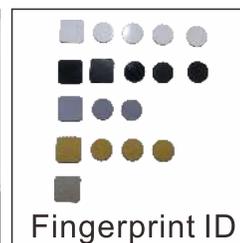
BM coating



IR sensor coating



Hard coating



Fingerprint ID



Fingerprint ID



可進行去膠渣、表面清潔、活化、改善、接枝或粗糙化等

特點

- 配備真空收料循邊專用模組，確保收料精度
- 採用閉迴路張力控制系統，確保張力控制穩定性
- 遠端控制系統，即時了解設備狀態提升稼動率
- 低張力傳輸，降低膜料脹縮量
- 採用多組水冷電極，提升處理效能、增加產能
- 水冷滾輪有效控制材料溫度，提高製程穩定性
- 腔體設計採用收、放捲與製程分區，避免汙染、腐蝕
- 專利快速安全夾頭，減少上下料操作時間
- 特殊之氣體進氣、擴散及抽氣系統設計



項目	規格
設備體積 (W×D×H)	3160mm×2950mm×2450 mm
工作參考面積 (D×W)	5400mm×5300mm
真空腔體 (W×D×H)	2470mm×1280mm×1860mm
需求電源	3相 220V, 60Hz, 4wires, 250A
Power Output	10KW MF power supply
Process line	8m
適用料捲幅寬	600mm(max)
適用料捲直徑	Ø600mm(max); plastic core(3"or 6")
滾輪尺寸	直徑100mm×寬800mm
線速度	1~10m/min
張力控制	30Nt~100Nt (3~10Kg)
循邊導正	±1mm
製程氣體	Ar、O ₂ (可擴充)



PVD & DLC Series Coating Equipment

◆ 類鑽石薄膜 (DLC)

高硬度 (Hv : 2000~3500) 、耐磨耗、抗腐蝕、低摩擦係數，可大幅提高模具及工具的使用壽命，可應用於精密模具 (含光學模具)、切削工具 (非鐵金屬)、沖壓模具...等

◆ PVD系列薄膜

可提供TiN、AlTiN、TiCN、AlTiCrN、TiAl_xSi_xN、Ti_xSi_yN、CrN...等多元具有高硬度 (Hv : 3000~4200)、耐磨耗薄膜，可應用於精密模具、切削刀具、沖壓模具、汽機車紡織零件、耐磨耗零件...等

◆ CVD系列薄膜

可提供TiN、TiCN、Al₂O₃等薄膜，具有高硬度 (Hv : 2500~3500)、高附著力、高熱穩定性、薄膜厚度可達5~20μm，可應用於車 (銑) 削刀片、需耐磨耗之零件及模具

特殊薄膜

◆ 鑽石薄膜

高硬度 (Hv : 7000~9000)、低摩擦係數、耐腐蝕、耐磨耗、高熱傳係數，可應用於切削工具 (如石墨、碳纖維、陶瓷材料...等難加工材料之切削)、散熱材料、半導體材料、電化學電極 (P-type Diamond)

◆ 彩虹鑽石(彩鑽)薄膜

奈米、抗沾黏、低摩擦係數、耐磨耗，能有效改善排屑、減少刀具沾黏、改善板邊品質並提升刀具壽命，主要適用於鋁、銅、塑膠...等非鐵金屬材料加工

◆ TA複合薄膜

高硬度 (Hv : 3000~3500)、低摩擦係數、排屑性佳，主要用於切削不鏽鋼材料 (304,316)

◆ TS複合薄膜

高硬度 (Hv : 3500~4200)、低摩擦係數、排屑性佳，主要可用於切削高硬度熱處理材料 (HRC 50度以上)、鈦合金、鎳基合金..等難切削材料



PVN Series

機台尺寸(WxDxHmm)	1900x4000x2100mm
有效鍍膜空間	Ø480xH550mm

特點

- 可替換式陰極電弧及磁控濺鍍鍍膜技術
- 矩形靶源(2~4組)或6吋圓形靶源模式(4~8組)
- 系統採八邊形不銹鋼腔體，夾層式水路冷卻
- 搭載4組Heater，可均勻升溫至450°C
- 搭載超高真空渦輪幫浦
- 8軸3層公自轉機構，產能大且膜層均勻
- 置具台車方便Loading /Unloading生產
- 全自動化鍍膜生產，可遠端網路診斷及程式除錯
- 可鍍膜種類：TiN、CrN、ZrN、TiX-H、TiAlN、AlTiN、AlCrN、AlTiCrN...



應用

- 銑削、車削、鑽孔、攻牙之刀工具



- 成型、沖壓之模具

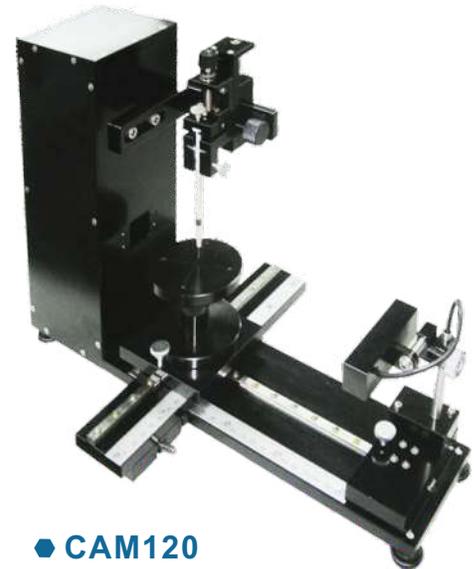


特點

- 可量測液滴平均角度
- 左右液滴角度
- 液滴體積、液滴直徑、靜/動態量測等
- 量測後數據可儲存成 EXCEL 檔、繪製成曲線圖
- 可同時自動量測角度及監控實際水量
- 量測資料可同步儲存於網路硬碟

應用

- 印刷電路板 (PCB) 或電子元件上有機污染物的檢查
- 固體表面之親疏水性分析
- 生物學相關研究之應用，ex.蛋白質之特性分析與檢測
- 各式基材之表面檢測

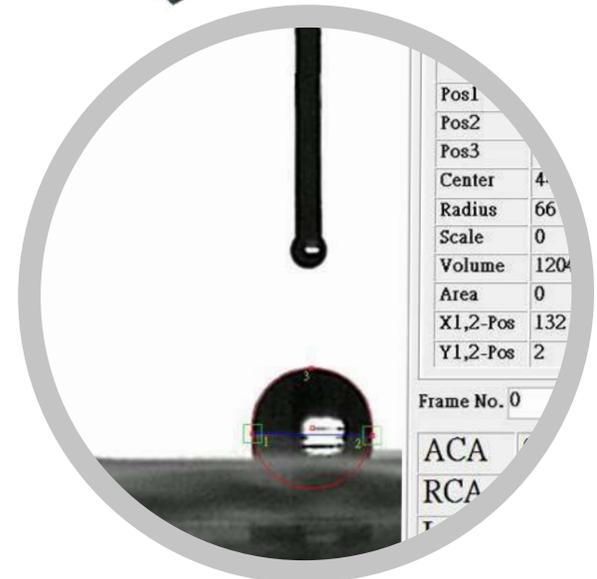


● CAM120



● CAM210

項目	CAM120	CAM210
硬體規格		
光學系統	CCD Camera	
儀器尺寸	L410xW250xH300mm	L138xW77xH196mm
儀器重量	3.5Kg	1.6Kg
電源	USB 2.0介面(不需外加電源線)	
樣品台	高度: 80mm 直徑: 80mm	--
樣品大小	長無限制 寬 ≤ 170mm 高 ≤ 60mm	長 > 140mm 寬 > 77mm 高無限制
解析度	800x600pixel	
光源	LED燈(感光度可由軟體介面調整)	
載台可調範圍	X: 140mm Y: 240mm Z: 10mm	--
軟體規格		
適用作業系統	Windows XP SP2、Windows Vista Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 及 Microsoft.NET Framework2.0 套件	
量測方式	靜態量測(平均接觸角、左右接觸角)、 動態量測、液滴體積量測、液滴直徑量測	
量測範圍	0~180°	
影像格式	AVI 檔 可自行設定影像擷取時間 可量測 AVI 檔中任一張畫面的角度	
資料分析	資料分析量測數據資料轉存為 excel 檔， 量測數據可繪製成曲線圖並可儲存 jpg 檔， 便於大量數據的分析	
表面自由能	計算方式： (a) Owens method (b) Wu method (c) Oss&Good method 具備液體參數資料庫、可自行建立液體特性參數	



功能

- 符合電漿特性設計的電器規格，提供定功率、定電壓及定電流功能
- 內建電弧保護系統，確保設備穩定運行
- 配備過電壓、過電流、過熱及過載保護機能，提升安全性
- 支援單相或雙相火線電漿系統應用
- PLC使用者介面兼容AE-Pinnacle或ADL-GSW（選擇其一）



特點

- 數位控制系統
- 設定範圍廣
- 高電漿密度
- 可客製化洽詢

應用

- 真空鍍膜製程之清洗處理
- 電漿輔助化學沉積製程
- 電漿輔助濺鍍製程



規 格	DCPS001	DCPS002	DCPS-X	DCPS-X2
輸出需求				
電壓	單相 AC220V		三相 AC220V	三相 AC380V
電流	10A	15A	42A	45A
頻率	50~60Hz			
輸出特性				
功率	1kW	2kW	10kW	20kW
電壓	1200V		1500V	1000V
電流	2A	4A	13.3A	40A
通訊介面				
PLC Port	25 Pin (類比控制)			
尺 寸				
(H)×(W)×(D)mm	(3U)133×484×626		(4U)179×498×733	(5U)224×496×907
冷卻方式				
模式	氣冷		兼具氣冷與水冷方式	

※詳細 Model 名稱與規格，請參考 CNT 電漿電源系列標準品總表



電漿電源系列標準品

Standard type of Plasma power supply list

Power Type	Model	Power Rating (kW)	Input Voltage Rating(V)	Output Voltage max.(V)	Output Current max.(A)	Output Frequency max.(kHz)	Mechanical WxDxH(mm)	Cooling
MF	MFPS001	1	1 Φ 220V	1100AC	3	40kHz or 60kHz	484x626x133	Fan
	MFPS015	1.5	1 Φ 220V	700AC	5		484x626x133	Fan
	MFPS-X	10	3 Φ 220V	890AC	24		498x718x179	Water
			3 Φ 380V	890AC	24			
	MFPS-X-1100	10	3 Φ 220V	1100AC	24	498x718x179	Water	
			3 Φ 380V	1100AC	24	498x718x179	Water	
	MFPS-X2	20	3 Φ 220V	600AC	45	40kHz	496x894x224	Water
MFPS-X2-1100	20	3 Φ 220V	1100AC	45	40kHz	496x894x224	Water	
DC	DCPS001	1	1 Φ 220V	1200DC	2	No Frequency	484x626x133	Fan
	DCPS002	2	1 Φ 220V	1200DC	4			
	DCPS-X	10	3 Φ 220V	800DC	25	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X	10	3 Φ 220V	1000DC	20	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X-1500	10	3 Φ 220V	1500DC	13.3	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X2	20	3 Φ 380V	1000DC	40	No Frequency	496x907x224	Water
Pulse-DC	PDPS001	1	1 Φ 220V	600DC or pulse	5	50kHz	483x630x129	Fan
Pulse-DC	PDPS002	2	1 Φ 220V	600DC or pulse	8	50kHz	483x630x129	Fan



◆ 1kW/2kW



◆ 10kW



◆ 20kW



功能

- 符合電漿特性設計的電器規格，提供定功率、定電壓及定電流功能
- 內建電弧保護系統，確保設備穩定運行
- 配備過電壓、過電流、過熱及過載保護機能，提升安全性
- 支援單相或雙相火線電漿系統應用
- PLC使用者介面相容於AE-PEII

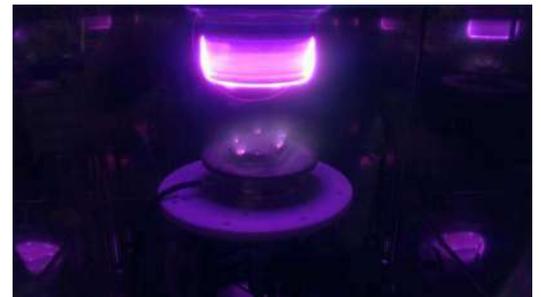


特點

- 數位控制系統
- 設定範圍廣
- 高電漿密度
- 可客製化洽詢

應用

- 電路板製造業之除膠渣製程
- 面板，玻璃，塑膠產業之表面清潔
- 電漿輔助化學沉積製程



規 格	MFPS001	MFPS-X	MFPS-X2
輸出需求			
電壓	單相 AC220V	三相 AC220/380V	三相 AC220V
電流	10A	40A	80A
頻率	50~60Hz		
輸出特性			
功率	1kW	10kW	20kW
電壓	1100V	1100V	1100V
電流	3A	24A	45A
頻率	40kHz		
通訊介面			
PLC Port	25 Pin (類比控制)		
尺 寸			
(H)×(W)×(D)mm	133 x 484 x 626	179 x 498 x 718	(5U)224 x 496 x 894
冷卻方式			
模式	風冷方式	兼具風冷與水冷方式	

※詳細 Model名稱與規格，請參考CNT電漿電源系列標準品總表



電漿電源系列標準品

Standard type of Plasma power supply list

Power Type	Model	Power Rating (kW)	Input Voltage Rating(V)	Output Voltage max.(V)	Output Current max.(A)	Output Frequency max.(kHz)	Mechanical WxDxH(mm)	Cooling
MF	MFPS001	1	1Φ220V	1100AC	3	40kHz or 60kHz	484x626x133	Fan
	MFPS015	1.5	1Φ220V	700AC	5		484x626x133	Fan
	MFPS-X	10	3Φ220V	890AC	24		498x718x179	Water
			3Φ380V	890AC	24			
	MFPS-X-1100	10	3Φ220V	1100AC	24	498x718x179	Water	
			3Φ380V	1100AC	24	498x718x179	Water	
	MFPS-X2	20	3Φ220V	600AC	45	40kHz	496x894x224	Water
MFPS-X2-1100	20	3Φ220V	1100AC	45	40kHz	496x894x224	Water	
DC	DCPS001	1	1Φ220V	1200DC	2	No Frequency	484x626x133	Fan
	DCPS002	2	1Φ220V	1200DC	4			
	DCPS-X	10	3Φ220V	800DC	25	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X	10	3Φ220V	1000DC	20	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X-1500	10	3Φ220V	1500DC	13.3	No Frequency	498x733x179	Water
	DCPS-X2	20	3Φ380V	1000DC	40	No Frequency	496x907x224	Water
Pulse-DC	PDPS001	1	1Φ220V	600DC or pulse	5	50kHz	483x630x129	Fan
Pulse-DC	PDPS002	2	1Φ220V	600DC or pulse	8	50kHz	483x630x129	Fan



◆ 1kW/2kW



◆ 10kW



◆ 20kW

